

シリコンウェーハ特集の発刊にあたって

Remarks on Special Issue on Silicon Wafers



シリコンウェーハ事業部長

西谷 徳治 Tokuji NISHITANI

21世紀を迎えようとしている今、マイクロエレクトロニクス時代が全世界的に拡大・深化しており、パソコン、携帯電話、カーエレクトロニクス、デジタル家電等が、企業や個人の活動に不可欠のツールとして、われわれのライフスタイルに画期的な変革をもたらしつつあります。

マイクロエレクトロニクス時代を支える半導体デバイスは、年率2桁の成長が予想されております。

シリコンウェーハは、その半導体の不可

欠かつ理想的な基盤材料として、質・量ともに益々重要な役割を期待されています。半導体の大口径化、微細化の進展が加速化している中、お客様のご要望も一段と高度化、多様化しております。

新日本製鐵はシリコンウェーハ事業を開始して15年。鉄から発した総合素材メーカーとしての研究開発ポテンシャルを、商品開発、プロセス開発面にフルに発揮して、お客様の御要望に応えるべく努力を重ね、5インチ、6インチ、8インチウェーハへと12インチの研究開発も含め、事業基盤を広げてまいりました。

本特集では、これまで新日本製鐵が手がけた研究開発の成果の一端を御紹介致します。本特集を通じて、私どもの目指すところを理解され、技術開発の御参考にしていただければ幸いです。

新日本製鐵は引き続き、商品ニーズ、技術トレンド等を見据え、お客様の御期待に沿うべく努力してまいります。

今後とも、なお一層の御支援と御指導を賜りますようお願い致します。